| 산업통상자원부 | 보도참고자료 | 다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라 |
|---|---|---|

| 보도 일시 | 2023. 3. 1.(수) 배포즉시 | 배포 일시 | 2023. 3. 1.(수) |
|---|---|---|---|
| 담당 부서 <총괄> | 첨단산업정책관 반도체과 | 책임자 | 과 장 이규봉 (044-203-4270) |
| | | 담당자 | 서기관 차세운 (044-203-4271) |
| | 통상정책국 미주통상과 | 책임자 | 과 장 이승헌 (044-203-5650) |
| | | 담당자 | 사무관 윤경민 (044-203-5658) |

# 미(美) 상무부, 반도체지원법 혜택 세부계획 발표

## - 반도체 제조시설에 대한 재정 혜택 신청요건·절차 등 공고 -

□ 산업통상자원부(장관 이창양)는 2월 28일(화) 19시(한국시간) 美 상무부가 **미국 반도체지원법***상의 인센티브 프로그램 중 **반도체 제조시설**에 대한 재정 인센티브의 세부 지원계획을 공고**했다고 밝혔다.

* CHIPS and Science Act (`22.8월 발효) : 반도체 산업에 대한 재정지원 527억불 (시설투자 인센티브 390억불 포함), 투자세액공제 25% 등을 규정
→ 금번 발표내용은 상기 시설투자 인센티브 중 제조시설에 대한 지원 계획임
(소재·장비, R&D 관련 시설투자 지원계획은 추후 발표 예정)

** 재정지원 공고(Notice of Funding Opportunity)

□ 금번 공고에 따른 지원 대상은 미국에서 **최첨단·現세대·성숙노드** 반도체의 **前공정** 또는 **後공정** 제조시설의 **건축·확장·현대화 투자**를 진행하려는 기업들로, 동 기업들은 **보조금**, **대출**, 또는 **대출보증**의 방식으로 지원받을 수 있다.

□ 인센티브 신청 의향이 있는 기업은 **2.28일부터 의향서**(Statement of Interest)를 美 상무부에 우선 제출한 후,

○ **최첨단 제조시설*은 3.31일부터**, 그 외 現세대·성숙노드 또는 후공정 제조시설은 6.26일부터 **본 신청서를 제출**토록 하고 있다**.

* (로직칩) EUV를 대량생산에 활용 (메모리칩) 200단 이상 낸드, 13nm 이하 하프피치 D램

** 희망기업은 본 신청서 제출에 앞서 사전신청서 제출 가능

□ 美 상무부는 기업들이 제출한 신청서를 **경제·국가안보**, 투자계획의 **상업적 타당성**, 신청기업의 **재무상태** 및 **투자이행 역량**, **인력개발** 및 그 외 **파급효과** 등의 여러 측면에서 종합적으로 검토하게 되며,

< 요소별 고려사항 예시 >

- 경제·국가안보 : 미국 내 생산증대 효과, 외국 우려기업 리스크 등
- 상업적 타당성 : 생산제품의 수요/공급 전망 등
- 재무상태 : 신청기업 재무상태, 재원확보현황(주·지방정부 인센티브 지원 등) 등
- 투자이행 역량 : 건설계획, 기술·제조계획의 타당성 등
- 인력개발 : 인력 확보 및 훈련계획, 보육서비스 제공 등
- 그 외 파급효과 : 미래투자 약속, 기후·환경 책임성, 미국산 철강 활용 의향, 자사주 매입제한 계획, 초과이익 공유* 등

* 1.5억불 이상 지원받는 기업은 당초 제출한 기대수익을 크게 초과하는 수익을 낼 경우 보조금 75%까지 환수

○ 이에 대한 기업과의 심층적인 논의·협상을 거친 후 인센티브 지원 규모·방식 등을 확정하게 될 것이다.

□ 다만, 미국 반도체지원법(“가드레일 조항”)에 규정된 바와 같이, 동법상 인센티브를 지원받는 기업은 향후 **10년간 우려대상국에서의 반도체 제조 능력 확장과 관련된 거래를 제한**받게 될 것이며, 이와 관련한 **세부사항은** 美 정부에서 **추후 발표할 예정**이다.

□ 금번 美 상무부 발표에 따라, 美 반도체지원법 인센티브를 수령할 의향이 있는 기업들은, 인센티브 수령시의 혜택과 의무 등을 종합적으로 고려하여 인센티브 규모 및 지원조건에 대한 협상을 美 정부와 진행하게 될 것이며,

○ 우리 업계는 美 반도체지원법 인센티브 프로그램에 관해서는 현 단계에서 예단하지 않고 美 정부와 협의를 하면서 최선의 방안을 마련하겠다는 입장이다.

□ 그간 정부는 **가드레일 조항** 등과 같이 우리 기업 경영에 과도한 부담을 줄 수 있는 사항에 대해서는, 업계와 대응방안을 논의한 후 미 상무부 등 관계당국에 우리측 입장을 적극 개진해 왔으며,

* 美 반도체지원법 발효 직후 가드레일 조항 관련 긴밀한 협의를 당부하는 상무장관 앞 서한 송부(`22.8월), 이후 다양한 채널로 미측과 협의 진행

○ **가드레일 세부규정** 마련 과정에서 **우리 기업 입장이 충분히 반영**될 수 있도록 앞으로도 **美 관계당국과 계속 협의**할 예정이다.

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락